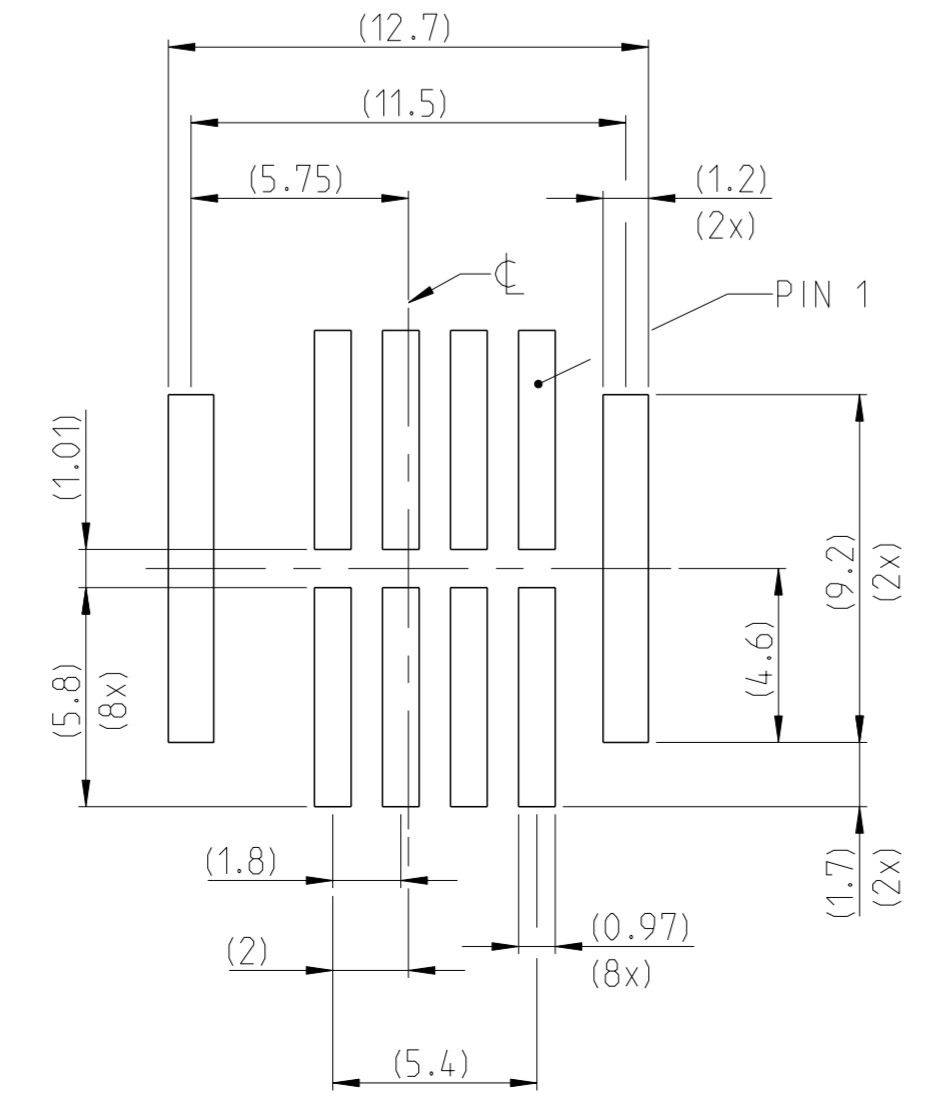
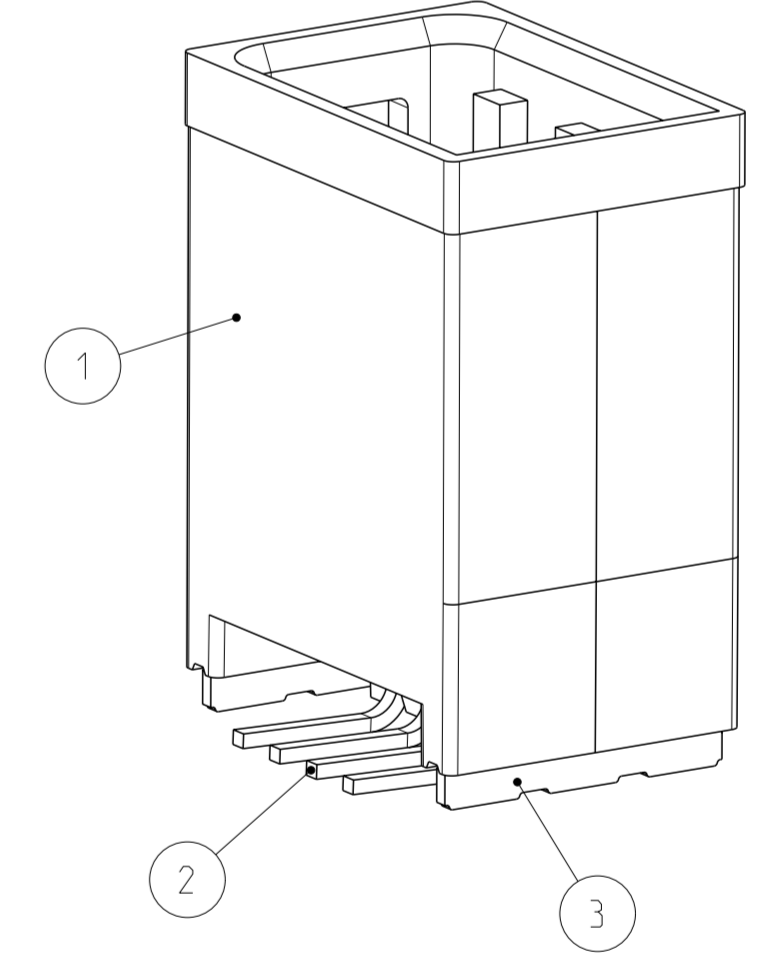


POSSIBLE PCB LAYOUT  
 CUSTOMER IS RESPONSIBLE FOR LAYOUT  
 Mögliches Leiterplattenlayout  
 Kunde ist fuer Leiterplattenlayout verantwortlich



- NOTES  
 Bemerkungen
- 1 PRESS OUT FORCE FOR NANOMQS CONTACT >15N WITH FEED RATE 25mm/min  
 Kontaktausdruckkraft fuer NanoMQS Kontakt >15N mit Vorschubgeschwindigkeit 25mm/min
  - 2 PRESS OUT FORCE FOR SOLDER BRACKET >60N WITH FEED RATE 25mm/min  
 Kontaktausdruckkraft fuer Loetblech >60N mit Vorschubgeschwindigkeit 25mm/min
  - 3 INTERFACES ACC. TO 114-94000-20. REV. A1, Version 1.  
 Schnittstellen nach 114-94000-20. Rev. A1, Version 1.
  - 4 INTERFACE IS NOT PART OF PPAAP. TE CONNECTIVITY IS RESPONSIBLE FOR CONNECTOR SYSTEM  
 Schnittstelle ist nicht Bestandteil des PPAAP. TE Connectivity ist verantwortlich fuer Stecksystem
  - 5 TOLERANCES ACC. TO DIN EN ISO 8015. DIN EN ISO 14405-1  
 GENERAL TOL. ACC. TO DIN 16742 TGS. EXCEPT ANGLE DIM. (SEE TITLE BLOCK)  
 Tolerierung nach DIN EN ISO 8015. DIN EN ISO 14405-1  
 Allgmeintoleranzen nach DIN 16742 TGS. ausser Winkelmasse (siehe Schriftkopf)
  - 6 PACKAGING IN TAPE & REEL ACC. TO V2317523  
 Verpackung in Tape & Reel nach V2317523
  - 7 SOLDER BRACKET SURFACE 3-8µm Sn OVER 1.0-2.5µm Ni  
 Loetblechoberflaeche 3-8µm Sn ueber 1.0-2.5µm Ni
  - 8 CONTACT SURFACE SOLDER SIDE 3-8µm Sn OVER 1.0-2.5µm Ni. MATING SIDE Sn ACC. 114-94201  
 Kontaktoberflaeche Loetseite 3-8µm Sn ueber 1.0-2.5µm Ni. Steckseitenach Sn nach 114-94201
  - 9 FOR MISSING DIMENSION SEE CAD-MODEL 2317523. REV. A  
 Fehlende Masse sind dem CAD-Model 2317523. zu entnehmen. rev. A
  - 10 AREA FOR GOOD PART MARKING: WITH PUNCH MARK OR LASER MARKING  
 Bereich fuer Gueteilmarkierung: Mit Koernerpunkt oder Lasermarkierung
  - 11 ELECTRICAL 100% FINAL INSPECTION FOR CONTINUITY AND SHORT CIRCUIT  
 AS WELL AS EXISTENCE OF ALL CONTACTS  
 Elektrische 100% Endpruefung auf Durchgang und Kurzschluss,  
 sowie das Vorhandensein aller Kontakte
  - 12 REFERENCE POINTS A5.6.7.8 ARE ON OPPOSITE SITE OF A1.2.3.4  
 Bezugspunkte zu A5.6.7.8 auf gegenueberliegender Seite von A1.2.3.4
  - 13 SOLDERING PROCESS: LEAD-FREE REFLOW SOLDERING IN REFERENCE TO JEDEC J-STD-020D  
 Loetprozess: Bleifreies Loeten in Anlehnung an JEDEC J-STD-020D
  - 14 COLOURED IDENTIFICATION MARK FOR C-SAMPLES  
 Farbliche Markierung fuer C-Muster
  - 15 PINS OPTIONAL ALLOWED, BUT AT CPA-CONNECTOR WITHOUT ELECTRIC FUNCTION  
 Pins optional zulassig, aber bei CPA-Stecker ohne elektrische Funktion
  - 16 CUT OUT WITH PLAIN STAMPING EDGES  
 Ausschnitt mit blanken Stanzkanten
  - 17 POSITION OF HOUSING PN, REVISION AND MATERIAL MARKING MAY DIFFER FROM SERIES TO PRE-SERIES  
 Position der Gehaeuse-PN, Revision und Materialkennzeichnung abweichend von Serie zu Vorserie



SERIES							PN: 2320008 - suitable Receptacle Housing w/o CPA						
x-	-1	-2	N/A	N/A	N/A	N/A	PN: 2312106 - suitable Receptacle Housing w/ CPA						
x-	-1	-2	N/A	N/A	N/A	N/A	Solder Brackets	-	A	Copper-Alloy	-	3	
B	8	8	8	8	8	8	NanoMQS Pin	-	A	Copper-Alloy	-	2	
-	-	-	-	-	-	1	BPos Header Housing	Z	A	PA4T-GF30	waterblue	5021	1
-	-	-	-	-	-	1	BPos Header Housing	F	A	PA4T-GF30	brown	1bd	1
-	-	-	-	-	-	1	BPos Header Housing	E	A	PA4T-GF30	green	1bd	1
-	-	-	-	-	-	1	BPos Header Housing	D	A	PA4T-GF30	claret-violet	4004	1
-	-	-	-	-	-	1	BPos Header Housing	C	A	PA4T-GF30	blue	5005	1
-	1	-	-	-	-	-	BPos Header Housing	B	A	PA4T-GF30	nature	-	1
1	-	-	-	-	-	-	BPos Header Housing	A	A	PA4T-GF30	black	9011	1
							DESCRIPTION	COD.	REV.	MATERIAL	SURFACE/COLOR	RAL (similar)	POS.
							Assy. Rev.						
							TE Part No.						
							Theoretical Weight (gr.)						
0-x-1	1.47	1.47	1.45	1.46	1.47	1.47							

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT. DATE: 08/MAR/2017  
 DRAWN BY: A. Lay, N. K. DATE: 11/APR/2017  
 CHECKED BY: K. H. DATE: 11/APR/2017  
 APPROVED BY: K. H. DATE: 11/APR/2017

400% Inspection

emk >= 1.67

Gauge Inspection

STE TE Connectivity

8Pos. NanoMQS. Header Assy.  
 6Pos+CPA  
 180Deg. SMD

00779 ©=2317523

SCALE: 5:1 SHEET: 1 of 1

0-2317523-1 AS SHOWN  
 wie gezeichnet